

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2018年10月4日(04.10.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/179074 A1

(51) 国際特許分類:  
H01L 21/60 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2017/012518

(22) 国際出願日: 2017年3月28日(28.03.2017)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

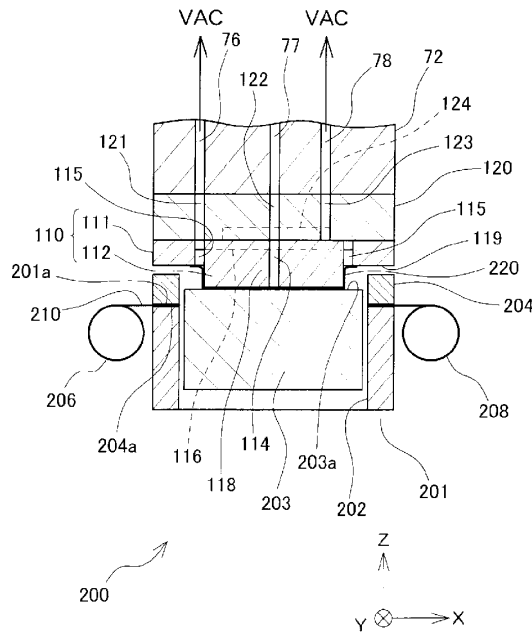
(72) 発明者: 瀬山 耕平(SEYAMA, Kohei); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特許事務所(YKI PATENT ATTORNEYS); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目 3 4 番 1 2 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING DEVICE

(54) 発明の名称: 電子部品実装装置



(57) Abstract: An electronic component mounting device (100) bonds a semiconductor die (150) to a substrate by thermocompression bonding, and seals, using an insulating resin, a gap between the semiconductor die (150) and the substrate. The electronic component mounting device is provided with: a film cutting mechanism (200) for cutting a long film (210) into cut pieces; and a mounting tool (110), which vacuum-sucks the semiconductor die (150), and bonds the die to the substrate by thermocompression bonding. Consequently, in the electronic component mounting device (100) that moves

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

a mounting head in the horizontal direction, adhesion of the insulating resin to the mounting tool can be suppressed.

(57) 要約: 半導体ダイ (150) を基板に熱圧着すると共に、半導体ダイ (150) と基板との隙間を絶縁樹脂で封止する電子部品実装装置であって、長尺フィルム (210) を切片状に切り出すフィルム切り出し機構 (200) と、半導体ダイ (150) を真空吸着して基板に熱圧着する実装ツール (110) と、を備える電子部品実装装置 (100)。これにより、実装ヘッドを水平方向に移動させる電子部品実装装置 (100) において、絶縁樹脂が実装ツールに付着することを抑制することができる。